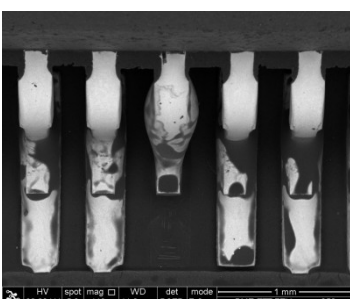
	<p><b><i>Elektronikai termékek hibaanalitikai és megbízhatósági vizsgálatain alapuló kutatás gyártási eljárások jelentős javításához</i></b></p>
<p><b>Projektvezető:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gordon Péter</li> </ul>	<p><b>Cél:</b> A projektek célja az elektronikai termékek gyártása során alkalmazott felületszerelési folyamatok kutatása hibaanalitikai és megbízhatósági vizsgálatokkal. Az egyes hibák analízise alapján megismert meghibásodási mechanizmusok jelentősen javíthatják a termékek újabb verzióinak megbízhatóságát.</p>
<p><b>Ipari megbízók:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nokia Komárom</li> <li>Sanmina Tatabánya</li> <li>Jabil Tiszaújváros</li> </ul>	<p><b>Eredmények:</b> A kutatás során felhalmozott új tudásanyag többek között a nyomtatott huzalozású lemezek és az alkatrészek forraszthatóságával kapcsolatos elemeket tartalmaz. A forraszthatóságot és ezáltal a forrasztott kötés minőségét is számtalan tényező befolyásolja: a felületi bevonatok megfelelősége, esetleges szennyeződések és gyártástechnológiai paraméterek nagy száma.</p> <p>A kutatás eredményei nem kizárólag a projekt lezárásakor, hanem folyamatosan vissza lettek csatolva a kutatást finanszírozó ipari partnerekhez, így segítve több szinten is a termékek és a folyamatok fejlesztését.</p>
<p><b>Időtartam:</b> 2009.01.01.-2012.09.30.</p>	

	<p><b><i>Research based on failure analysis and reliability investigations to significantly increase the quality of electronic products</i></b></p>
<p><b>Project Leader:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Péter Gordon</li> </ul>	<p><b>Aim:</b> Projects aimed at the research of surface mount technology processes at electronic production by failure analysis and reliability investigations. The failure mechanisms revealed by the analyses might significantly increase the reliability of new product versions.</p>
<p><b>Industrial partners:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nokia Komárom</li> <li>Sanmina Tatabánya</li> <li>Jabil Tiszaújváros</li> </ul>	<p><b>Results:</b> The knowledge accumulated during the research is mainly concentrated on the solderability of printed wiring boards and components. There are many factors affecting wettability and thus the quality of the solder joint. For example: acceptability of surface finishes, contaminations and several production technology parameters.</p> <p>Research results had been continuously fed back to the industrial partners financing the projects. This led to successful development of product and production processes.</p>
<p><b>Duration:</b> 2009.01.01.-2012.09.30.</p>	